



## **Rico Randegger**

**Leiter des Geschäftsbereichs After Sales  
Mitglied der Konzernleitung seit 2019**

Geboren 1973  
Schweizer Staatsangehöriger

### **Ausbildung**

Studium der Elektrotechnik an der NTB Buchs (HTL), Schweiz  
Nachdiplomstudium zum Wirtschaftsingenieur FH an der PHW Zürich, Schweiz

### **Beruflicher Werdegang**

Seit 2019	Rieter AG (bis 30. 4. 2024 Rieter Management AG), Winterthur, Schweiz Leiter des Geschäftsbereichs After Sales und Mitglied der Konzernleitung der Rieter Holding AG, Winterthur, Schweiz
2018 – 2019	Bosch Packaging Technology, Königsbrunn, Deutschland, Produktgruppenleiter Liquid Food
2015 – 2017	Ampack GmbH, Königsbrunn, Deutschland, CEO
2010 – 2014	Bosch Packaging Services AG, Beringen, Schweiz, CEO
2008 – 2010	Bosch Packaging Services AG, Neuhausen, Schweiz, Director Field Service
2003 – 2007	Sigpack Services, Inc., Raleigh (NC), USA, Business Analyst
2000 – 2002	Sigpack Systems AG, Neuhausen, Schweiz, Teamleiter Kundendienst
1998 – 2000	SIG Pack Systems AG, Neuhausen, Schweiz, Inbetriebsetzungsingenieur

### **Weitere Tätigkeiten und Interessensverbindungen**

Keine.